PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-219357

(43)Data of publication of application: 19.08.1997

(51)Int.CI.

H01L 21/027

G02F 1/1333

GOSF 7/20

(21)Application number: 08-

(71)Applicant: CANON INC

045678

(22)Date of filing:

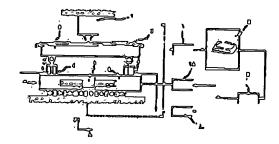
08.02.1996 (72)Inventor: TAKIZAWA TAKESHI

(54) ALIGNER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make it possible to use an aligner without taking the flatness of a chuck so seriously by conducting scanning with the position of a suction face of the chuck being so corrected that an exposed face of an exposed body may be within the depth of focus of an optical system based on the flatness of the chuck at the time of exposure.

SOLUTION: With a Z sensor 1 measuring the surface of a glass plate 2, an X stage is driven. At that time, a Z motor 4 being stationary at the origin, the amount of drive of the X stage 6 is monitored by an angelow



of the X stage 6 is monitored by an ancoder 5 and the values of the Z sensor 1 for X values are stored in a mamory 7. Then, these data are sent to a computer 8 to recognize the flatness of a chuck 3. Based on the flatness of the chuck, scanning is conducted by correcting means 9, 10, 11 with the position of a suction face of the chuck 3 being so corrected that the glass plate 2 which is an exposed body may be within the depth of focus of the Z sensor 1.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

29.06.2001

[Date of sending the examiner's

07.04.2004

decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

cited Reference /

(19)日本国特殊庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出職公開番号

特開平9-219357

(43)公費日 平成9年(1997)8月19日

(51) Int.CL.*	维 別包号	庁内整理番号	ΡI			技術表示箇所
HO1L 21/0	27		HOIL	21/30	518	
G02F 1/1	333 500		G02F	1/1333	600	
G03F 7/2	0 521		GOSF	7/20	52 1	
			H01L	21/30	5 2 6 Z	

春空開水 未開水 開水項の数6 FD (全 5 頁)

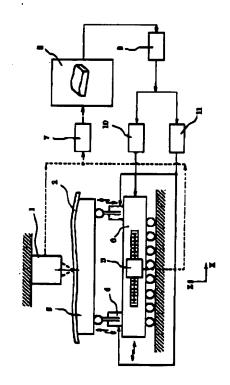
(21) 出版書号	特联平8 -45878	(71)出国人	000001007	
(22) 出版日	平成8年(1996) 2月8日		キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号	
		(72)免劳者	権权 載 神奈川県川崎市中原区今井上町83番組キヤ ノン株式会社小杉李梨所内	
		(74)代理人	弁理士 伊東 管也 (外1名)	

(54) 【発明の名称】 最光数量

(57)【要約】

【課題】 チャックの平面度やスキャン中におけるチャ ックの姿勢変化による被露光面の変化を低減する。

【技術手段】 薄板状の被露光体を吸着するチャック3 と、チャックに吸着された被露光体2上にマスクの像を 結像する光学系と、前記光学系と前記被露光体とを相対 的にスキャンさせる手段10とを具備するスキャン方式 露光装置において、前記チャックの平面度を予め測定す る手段1と、測定された平面度の状態を記憶する手段7 と、舞光時に、前記記憶手段に記憶された平面度の状態 に基づいて前配被露光体の被露光面が前配光学系の焦点 深度内に入るように前記チャックの吸着面の位置を補正 しながら前記スキャンを行わせる補正手段8、9、11 とを設ける。



(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 障板状の被重光体を吸着するチャック と、眩チャックに吸着された被罵光体上にマスクの像を 結像する光学系と、前記光学系と前記被露光体とを相対 的にスキャンさせる手段と、前記チャックの平面度を予 め測定する手段と、測定された平面度の状態を記憶する 手段と、電光時に、前配配億手段に配憶された平面度の 状態に基づいて前記被電光体の被電光面が前記光学系の 焦点深度内に入るように前記チャックの吸着面の位置を 補正しながら前記スキャンを行わせる補正手段とを具備 10 することを特徴とするスキャン方式露光装置。

1

【請求項2】・前記測定手段が前記スキャン舞光動作状 態における前配チャックのピッチングおよびローリング 量をさらに測定し、前記配憶手段が測定されたビッチン グおよびローリング量をさらに記憶し、前記補正手段が さらに前記記憶手段に記憶されたピッチングおよびロー リング量に基づいてこれらのピッチングおよびローリン グを低減すべく前記チャックの位置を補正することを特 徴とする請求項1記載のスキャン方式露光装置。

【請求項3】 前記載光時に前記光学系と前記被載光面 20 との距離を測定するフォーカスセンサをさらに備え、前 記測定手段は眩フォーカスセンサを用いて前記チャック の平面度ならびに、必要に応じてピッチング量およびロ ーリング量を測定することを特徴とする請求項1または 2 記載のスキャン方式電光装置。

【請求項4】 前記被露光体を前記光学系の焦点位置ま で駆動する2ステージと前記被戯光体をチルト駆動自在 なチルトステージとを具備し、前記チャックの平面度測 定後、前記補正手段は、これらのステージが前記マスク 面とチャック面の平行を保持すべく前記チャックの姿勢 30 を補正することを特徴とする情求項1~3のいずれかに 記載のスキャン方式電光装置。

【請求項5】 前配被露光体が液晶パネル製造用のガラ ス基板である饋求項1~4のいずれかに記載のスキャン 方式露光装置。

【請求項6】 前記被重光体が半導体製造用のウエハで ある請求項1~4のいずれかに記載のスキャン方式電光 差量。

【発明の詳細な説明】

[0001]

. 【発明の属する技術分野】本発明は、液晶パネル用ガラ ス基板や半導体ウェハ等の薄板状被露光体に所望のパタ 一ンを露光するための露光装置に関し、特に被露光体と 光学系とを相対的に走査(スキャン)して前記異光を行 うスキャン方式の露光装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】液晶パネル用ガラス基板等を露光する露 光装置において、被翼光体であるガラス基板は、平面度 の良い平面板(以下、プレートチャック)に真空吸着さ れ、平面矯正された状態で露光光を照射され、原板(以 50 し、その自重によりたわみが発生しても、使用可能にで

下、マスク)のパターンがガラス基板に転写される。こ のようなフォトリソグラフィ技術においては、パターン 転写の際の焦点深度が数十ミクロンと小さいため、プレ ートチャックの吸着面の平面度は、焦点深度よりもざら に小さい値になるように、機械加工により面精度を仕上 げている。

【0003】豊近は、ガラス基板の大型化が進んでお り、それに伴ってプレートチャックの大きさも大きくな っている。したがって、プレートチャックのガラス吸着 面積も広くなり、機械加工により吸着面全面の精度を数 ミクロンに仕上げることは、困難になりつつある。

【〇〇〇4】さらに、プレートチャックの大型化によ り、その重量も増し、プレートチャックの保持方法によ っては、自重によるたわみが無視できない量になる。

【0005】また、一方では液晶パネルのコスト低減に 向けて、装置のスループットの向上要求が進み、この対 策のひとつとして露光時間の短縮が命題になっている。 このことから、プレートステージ(スキャンステージ) には、より高加速化、高速化が要求され、露光中(スキ ャン中) のプレートチャックのピッチング量、ローリン グ量も大きくなる。これらによるデフォーカス量も無視 できない量である。

【0006】また、特開昭61-287229号に開示。 されたように、ガラス基板の面精度を測定し、その測定 結果をもとに解像不良を警報器により表示する技術もあ るが、プレートチャックの大型化に伴うチャックの製造 の容易化に対しては、解決策にはなり得ない。同様に、 チャックの自重たわみやスキャン中の姿勢変化(ピッチ ング、ローリング) に対する解決策にもなり得ない。 【0007】さらに、半導体装置製造用の半導体ウエハ をウエハチャックに吸着してスキャン電光する露光装置 においても同様の問題がある。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】このように、従来の露 光装置においては、プレートチャックやウエハチャック 等のチャックを広い面積に渡って平面度数ミクロンに仕 上げる必要があり、さらにチャックの保持方法によって は、チャックの自重たわみも無視できない値になること から、チャックの製造は大変困難になり、また、コスト 40 の高いものになってしまう。

【0009】また、特開昭61-287229号のよう に被露光体の平面度を測定し、不良の際には警報により 表示を行う方法もあるが、チャックの製造に容易にする ものではない。

【0010】本発明の第1の目的は、チャックの平面度 を全面において出さなくても、使用可能にできるシステ ムを提供し、チャック製造の時間、コストを低減させる ことにある。

【0011】本発明の第2の目的は、チャックが大型化

(3)

铃関平9-219357

3

包含システムを提供することにある。

【0012】 本発明の「30目的は、スキャン中におけるチャックの登録変化(ピッチング、ローリング)を測定し、その①を初正して「○光可能なスキャン〇光度[②を提供することにある。

[[E100]

【風想を開発するための季服】本発明では、これらの問題点を開発するため、使用されるチャックの平面度を予め測定しておき、そのデータをもとに同光中のチャックを、上下(2)方向および傾倒(チルト)方向に福正理 10 団し、口板状況日光位の独口光面を常に口点面(第0 西)に近づけるようにしたことを特徴とする。

【0014】 本契明の好きしい契稿例において、前記チャックの国光頭作中のピッチング溶よびローリング員を予め測定して前記平面度とともに配包しておき、真殿の国光時に、前記平面度の福正とともに配包したピッチングおよびローリングを打ち消すべく前記チャックの位置を編正しながら国光する。また、前記光学系と前記後国光依の徳国光面との随風を測定するフォーカスセンサを、前記チャックの平面配測定やピッチングおよびローリング □ 測定に利用する。また、国光時は、徳国光体を前記光学系のほ点位置まで駆動する Z ステージおよび被風光体をテルト国項自在なチルトステージを制御して、マスク面とチャック面を常時平行に加正する。

[0015]

『冥施の感句』従来の『光慈』には、過常、徳原光面を 光学系の〔点面に合わせるために、ある基準面から徳原 光面をでの夏度を創定する変位センサ(以下、Zセン サ)と、徳原光面を無点面にまで『切する Z 国 位系(以 30 下、Z ステージ)および徳原光面の傾きを変える傾倒。 位系(以下、テルトステージ)を伺えている。

【0016】チャック上に設送された益記光体は、チャックに真空吸引された私、2センサにより益記光闘までの題目を図点(一段には3点)計刻され、これらの创をもとに2ステージおよびチルトステージによって、徳記光面を分点面に近づけられる(この動作を、以下、フォーカス合せという)。

【0017】この状態でチャック上の被回光体はマスクと平行に保たれ、かつ、マスタと途回光体が、同方向に 40 同超度で回光の光束の中を過過することにより、マスクのパターンを協回光体上に転写する。

【0018】上記の従来に成に対し、な発明の好ましい 又随の認知では、チャックの形状(平面度)を予めメモリして紹全、その形状に応じて区光中に Z ステージ、およびチルトステージを国立し、 G 光面全面を焦点面に近づけて 区光することを得位とする。

【0019】チャック、例えば商品パネル用ガラス品板を囚光する口光協口のプレートチャックの形状は、次の手順で阅定する。まず、チャック上に協口光松であるガ 50

ラス高級を吸口させ、2ステージおよびテルトステージをニュートラルの位置にセットする。この状態で、①光光を照射せずに②光だけの動作を行い、②光位量に対する2センサの値を睨み込みメモリにインブットしておく。これで、プレートテャックの形状は、図章できたことになる。

【0020】
京駅に河定しているのは、ガラス基板の泉面である。これは、河常、チャック窓面は、泉戸和からってあったり、ガラス基板との競協面和を低減するためピンチャックになっており、回徳チャック製面を測定することは國際であるからである。別定に同し、ガラス基板の毎回は完分な和配で均一であるとする。らし、ガラス基板の毎回の均一さが伊延できないび、京即があるのならば、石英等で盛むプレートを作成し、それを用いれば良い。

【0021】1 区で全面回光できない場合は、プレートステージを風動(ステップ)し、次に回光する面について各回包に、質り返し測定を行えば良い。

【0022】 また、実際の母光と同じ会件(加遠度、遺産)の時のチャックのピッチング、ローリングを測定することにより、図光時に現金するピッチング、ローリング日が認識できる。

【0023】この後、実際の懲光励作に入っていく。まず、従来と同題にガラス盗板の中央で、2センサによりガラス登板のフォーカス合せを行う。その次に、先に測定したプレートチャックの形状の包およびピッチング、ローリング①の値を層いて、四光中におけるガラスプレートの表面(協図光面)が、瓜点位位に対して2位位のずれまたは傾倒ずれを紅力小さくするように、母光位位の各ポジション毎に2ステージおよびチルトステーシを 福正国頃させながら回光していく。このようにして、ガラス盗紘にマスクのパターンを伝写していく。ステップして全面を図光するときも、同様である。

[0024]

【作用】 容発明に係る協品パネル用ガラス高板区光用区 光電 によれば、プレートチャックの平面度が光学系の 無点 深度より大きくても、 2ステージ および チルトステージの 図面 こより小さければ、 福正可能である。 また、チャック自重によるたわみが 発生しても、 その傾斜 ごか テルトステージの 図面 こよりら小さければ、 福正可能である。 したがって、プレートチャックの 平面度が 従来の 報度より 暴くても、 装配 に 経 域 可能となる。

【0025】をらに、チャックの平面度別定を行う顧に、真顧の日光を行う時と同じ加短度、同じ日光過度にて測定を行えば、スキャン時におけるプレートチャックのピッチングおよびローリングも測定可能になる。これら(ピッチング、ローリング変化に伴うデフォーカス員もキャンセルすることができ、より理想的な囚光が可能となる。

(4)

【0026】なお、半導体装置製造用の半導体ウエハを ウエハチャックに吸着して露光する露光装置において も、上記の液晶パネル用ガラス基板電光用のものと間様 に作用する。

[0027]

【実施例】以下、図面を用いて本発明の実施例を説明す る。

[第1の実施例] 図1は、本発明の一実施例に係るミラ ースキャン方式の露光装置の構成を示す。同図におい て、1は2センサ、2はガラスプレート、3はガラスプ 10 レート2を真空吸着し平面矯正するチャック、4は2駆 動モータ、5はX方向の位置を検出するエンコーダ、6 はメステージ、7はエンコーダ5の出力に対する2セン サ1の出力を記録するメモリ、8はメモリ7のデータか らチャック3の表面形状を認識するコンピュータ、10 は図示しないX配動モータのドライバ(Xモータドライ パ)、11は2駆動モータ4のドライバ(2モータドラ イバ)、9は形状医臓後の補正データを計算し、Xモー タドライバ10および2モータドライバ11へ指令を送 るコンピュータである。

【0028】上記構成において、Zセンサ1が、ガラス プレート2の表面を測定したままの状態で、Xステージ 6を駆動する。この時、Zモータ4は原点位置に静止し たままの状態である。Xステージ6の駆動量をエンコー ダ5によりモニタし、Xの値に対する2センサの値をメ モリ7に記録する。これらのデータをコンピュータ8に 送り、チャック3の表面形状を認識する。ここまでが、 チャック3の表面形状胞臓腫種である。

【0029】通常、装置1台に対してチャックは1枚で あり、そのチャックを使用し続けるため、チャックの表 30 面形状認識作業を1度行えばチャックを交換しない限 り、形状配験作業は、1度で良い。

【0030】また上記の形状認識作業を、実限の観光条 件(加速度、速度)で行うことにより、チャックのピッ チング、ローリングをも含んだチャック表面の形状認識 が可能である。

【0031】次に、実際の露光作業になったならば、コ ンピュータ8の形状の臓データをコンピュータ9に送 り、ガラスプレート2の表面形状が、最も平坦になるよ うに計算してから、Xモータドライバ10およびZモー 40 タドライバ11に指令を送る。これにより、Xステージ 6の位置に対応して、2モータ4が駆動され、露光光が 照射されているところのガラスプレート2の表面は、常 に理想高さに限り無く近い位置を保ちながら露光作業を 行うことが可能になる。

【0032】図2は、図1の露光装置を上から見た平面 図である。図2において、Zセンサ1は、3個(12、 1b,1c)配置されており、ガラスプレート2が図示 しないチャック3に真空吸着されたまま、図示しないX プレート2が、2センサを通過すると図中の点線の形状 が眩瞳できたことになる(図2-B)。次に、ガラスプ レート2をY方向にステップし、その状態で再度X方向 に駆動する(図2-C)ことにより、次のエリア(点 線)の形状が認識できる。この動作を繰り返すことによ

り、面積の大きなチャックでも形状の認識が可能にな る。

【0033】但し、このようにガラスプレート2をY方 向にステップ移動する場合は、X方向のみならずY方向 にもエンコーダが必要になる。また、図2において12 は氫光光の位置および形状を示す。

【0034】本実施例によれば、露光中はXステージ6 の位置に対応して、2モータ4を駆動し、少なくとも露 光光が照射されている部分のガラスプレート2の表面を 常に理想高さにしようとするため、被露光体であるガラ スプレートを真空吸着するチャック3の平面度が、露光 光の焦点深度より悪い(大きい)値であっても使用可能 である。また、ガラスプレートの大型化によりチャック も大きくなり、自重変形によりたわみが発生しても、補 20 正可能である。

【0035】さらに、スキャン時におけるプレートチャ ックのピッチングおよびローリング量の変化を測定し、 補正を行うことにより、ピッチングおよびローリングに よるデフォーカス量も同時にキャンセルすることが可能 であり、露光装置にとって、より理想的な露光が可能と

【0036】 [他の実施例] 上記の効果は、スキャン重 光方式であれば半導体露光装置に使用されるウエハチャ ックにおいても、全く同様な効果が期待できる。すなわ ち、本発明は、液晶パネル製造用の露光装置のみなら ず、半導体製造用の電光装置にも適用可能である。

【0037】近年、半導体においてもウエハ径が大型化 しており、ウエハを真空吸着するウエハチャックも大き くなり、広い面積を平面度良く加工するのは非常に困難 であり、コスト的にも高価なものになっている。

【0038】第1の実施例に係る図1の露光装置におい て、ガラスプレート2をウエハに、チャック3をウエハ チャックに置き換えれば、半導体露光装置における実施 例となる。

【0039】また、本発明は、レンズスキャン方式の重 光装置(ステッパ)にも適用可能であり、同様な効果が 期待できる。

[0040]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 ガラスプレートや半導体ウエハ等の被電光体を真空吸着 するプレートチャックやウエハチャック等のチャックの 平面度が、電光光の焦点凝度より悪い(凹凸差が大き い)値であっても、表面の形状を認識し、補正駆動する ことにより使用可能となる。また、被電光体の大型化に モータにより×方向に駆動される(図2-A)。ガラス 50 よりチャックも大きくなり、自重変形によりたわみが発 (5)

特開平9-219357

生しても、補正可能になる。さらに、スキャン時におけるチャックのピッチングやローリング量の変化を測定し、補正を行うことにより、ピッチングやローリングによるデフォーカス量も同時にキャンセルすることが可能であり、露光装置にとって、より理想的な露光が可能となる。

7

【図面の簡単な説明】

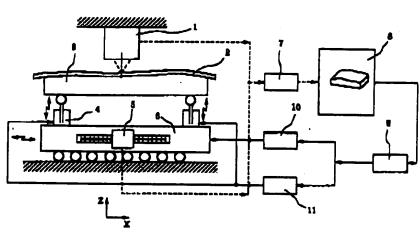
【図1】 本発明の一実施例に係るミラースキャン方式*

* の舞光装置の側面図である。

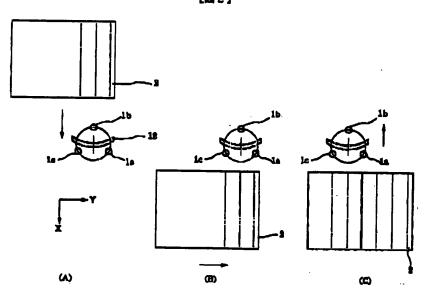
【図2】 図1の装置の平面図である。

【符号の説明】

1 (1 a、1 b、1 c): Zセンサ、2: ガラスプレート、3: チャック、4: Z駆動モータ、5: Xエンコーダ、6: Xステージ、7: メモリ、8, 9: コンピュータ、10: Xモータドライバ、11: Zモータドライバ、12: 電光光。



[图2]



Docket # 12002, 0978

Applic. # 10/717, 413

Applicant: Schedel et al.

Lerner Greenberg Stemer LLP
Post Office Box 2480
Hollywood, FL 33022-2480
Tel: (954) 925-1100 Fax: (954) 925-1101